

TSMC creará 8000 puestos de trabajo para el desarrollo y producción de chips a 3 nm

TSMC está expandiendo rápidamente sus operaciones en Taiwán, y eso incluye un expandir su centro de investigación en el que desarrollará el proceso litográfico de 3 nm, que haría su irrupción en el mercado en torno a 2022-2023.

Este centro de I+D contratará a otros 8000 ingenieros según ha indicado la compañía, para investigación del proceso en sí y la técnicas de producción.



Es el colofón del gasto de 50 000 millones de dólares que lleva invertidos TSMC en procesos litográficos avanzados en los últimos cinco años, lo que incluye también otros elementos como la creación de las herramientas y productos químicos para

generar las películas litográficas con las que se crean las capas de cada oblea.

El centro de investigación en el que trabajarán es en el del norte de Taiwán, si bien la fábrica de producción a 3 nm se situará en el Campus Científico del Sur de Taiwán. El proceso de producción a este nivel tiene nuevos retos a los que hacer frente como extender la producción con luz ultravioleta extrema al máximo número de capas posibles, o diversos defectos de origen desconocido que aparecen en la producción de obleas con luz UVE y que poco a poco se están corrigiendo.

La producción en masa de chips a 5 nm empezará en el segundo trimestre de 2020.

Fuente: TechSpot.